



ITEM NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
01	iW-PRFHZ-MD-01-R2.0-REL1.0	HEAT SINK	01
02	TiM	THERMAL PAD 0.5MM	01
03	M2.5 X 10MM	PAN HEAD SCREW	04
04	M2.5	M2.5 HEX NUT	04

DRAWN BY			<b>iWave System Technologies Private Limited,</b> 7/B, 29th Main, BTM Layout, 2nd Stage, Bangalore-560076, India.	
CHECKED BY			DRAWING NO:	
APPROVED BY		MATERIAL : AL-6063 T6		WEIGHT: In grams.
THIS DRAWING SHEET IS PROPERITY OF iWAVE SYSTEMS TECHNOLOGIES Pvt. Ltd.		FINISH : CLEAR ANODIZING		SUR AREA: In sqr.mm
GENARALTOLERANCES :		TITLE: HEAT SINK		REV: REL:
NOTES: ALL DIMENSIONS ARE IN MM. ROUND OFF ALL SHARP EDGES. SCALE:		DATE : 26/07/2018		SHEET 1 OF 1
X: ± 0.25 .X: ± 0.1 .XX: ± 0.01				

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Heat Sinks](#) category:*

*Click to view products by [iWave](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[581102B00000G](#) [656-15ABPE](#) [657-20ABPNE](#) [7020B-TC12-MTG](#) [73452PPBA](#) [7G0011A](#) [PF720G](#) [A22-4026](#) [HAH10L](#) [1542616-1](#) [HS-2506-F1](#) [HS-87M0-F2](#) [218-40CTE3](#) [231-69PAB-15V](#) [25-7520](#) [SW50-4G](#) [231-75PAB-13V](#) [231-75PAB-15V](#) [253-122ABE-22](#) [PSC22CB](#) [CLP212SG](#) [CLP-7701G](#) [HAA083](#) [HAF10L](#) [HAQ10T](#) [D10100-28](#) [TO5-002D](#) [BDN183CBA01](#) [3-21053-4](#) [32438](#) [TX0506-1B](#) [TX1806B](#) [LAE66A3CB](#) [WA-DT2-101E](#) [511-3U](#) [73381PPBA](#) [73403PPBA](#) [7G0047C](#) [COMX-440-HSP](#) [510-12M](#) [D10650-40T5](#) [V8511 Y](#) [APF40-40-13CB/A01](#) [780653U04500G](#) [ATS-54310K-C2-R0](#) [FK 216 CB SA](#) [FK 231 SA 220](#) [648-51AB](#) [657-20ABPESC](#) [2341BG](#)